

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2023-051

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于公司向银行融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币12亿元的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过10亿元的担保额度。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经2022年度股东大会审议通过。

近日，中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）同意给公司授信额度合计为人民币6,000万元，借款期限至2024年1月20日，由实控人赵积清先生、惠伦晶体（重庆）科技有限公司、新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）提供连带责任保证担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。

公司与中信银行无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

企业名称：中信银行股份有限公司

统一社会信用代码：91110000101690725E

注册资本：4893479.6573万人民币

成立日期：1987年04月20日

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；

从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、累计综合授信额度

如上述交易完成后，公司及子公司已获得的累计综合授信额度为人民币 96,340.00 万元，涉及的累计担保为人民币 71,800 万元，本次融资事项在 2022 年度股东大会决议审批额度内，由公司授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资有关的一切事宜，无需再提交董事会或股东大会审议。

四、交易目的及对公司的影响

公司进行银行融资交易，能够有效补充公司流动资金，促进经营发展。本次办理融资业务，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

中信银行综合授信合同及相关文件。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日